

# 深圳市龙图光罩股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券简称：龙图光罩

证券代码：688721

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位	华金证券、申万宏源、海通证券、中信证券、国泰君安、招商证券、东方证券、浙商证券、银河证券、华安证券、华福证券、方正证券、三花资产、河床投资、盈峰资本、鑫鼎基金、远东宏信、前海钰锦、金字塔投资、金鼎资本、国健安投资基金、亚太汇金基金、嶺信资本、红猫资管、宝莱特、新财道家族办公室
时间	2024年9月4日
地点	珠海市龙图光罩科技有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：柯汉奇 董事会秘书、财务总监：范强 总经理助理：邓少华 证券事务代表：李建东
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司基本情况</b></p> <p>深圳市龙图光罩股份有限公司成立于2010年，是具备关键技术攻关能力，拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模版厂商。</p> <p>公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售。公司紧跟国内特色工艺半导体发展路线，不断进行技术攻关和产品迭代，半导体掩模版工艺节点从1<math>\mu</math>m逐步提升至130nm，产品广泛应用于功率半导体、MEMS传感器、IC封装、模拟IC等特色工艺半导体领域，终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。</p> <p>公司于2022年8月设立珠海市龙图光罩科技有限公司，紧随国家半导体行业发展战略，围绕高端半导体芯片掩模版领域，持续加大研发投入，逐步实现90nm、65nm以及更高节点掩模版的量产与国产化配套，深耕特色工艺，突破高端制程，立志成为国际一流的半导体光罩企业。</p>

## 二、投资者互动交流

### 1、公司突破高端制程的过程中，是否会面临设备和材料方面的限制？

回复：公司主要原材料和光刻机采购依赖于境外且集中度较高，目前各国半导体贸易限制政策主要针对于先进制程相关产品，短期内不会对公司产生影响。另外，公司也积极与国产厂商保持紧密合作，加快国产化配套进程。

### 2、请问目前半导体掩模版根据制程节点划分的市场空间构成情况如何？

回复：公司结合下游主要客户调查问卷、行业研究报告等资料，推断目前国内 130nm 制程水平是分界线，130nm 以上和以下节点市场空间各占 50%，现中国大陆半导体掩模版国产化率较低，国产替代空间广阔。

### 3、请问公司未来产品的应用方向和公司业绩增长逻辑如何？

回复：公司募投项目主要针对第三代半导体掩模版产品，项目量产将使公司掩模版产品的制程水平提升至 130nm~65nm，进一步扩展公司适配的下游半导体产品，产品将应用于模拟芯片、MCU、DSP、CIS 芯片等，完善公司的产品和技术布局，增加公司的营业收入，提高公司市场竞争力。

### 4、公司对于深圳厂和珠海厂的安排和募投项目的投产节奏如何？

回复：深圳厂专注于 130nm 及以上制程，珠海厂主要负责 130nm 以下更高端制程。珠海厂为募投项目的实施主体，预计于今年第四季度实现第三代掩模版小规模试产。

### 5、为什么先进制程晶圆厂都选择自己配套掩模版而不是从第三方采购？

回复：由于 28nm 及以下的先进制程晶圆制造工艺复杂，且掩模版涉及重要工艺机密，制造难度较大，因此先进制程晶圆厂所用的掩模版大部分进行内部配套，如英特尔、台积电、中芯国际等。对于 28nm 以上等较为成熟的制程所用的掩模版，芯片制造厂商为了降低成本，在满足技术要求下，更倾向于向独立第三方掩模版厂商进行采购，例如联电、华虹宏力、格罗方德等。

**6、在目前的掩模版竞争格局中，公司的竞争优势有哪些？**

回复：（1）研发与创新优势。公司的研发团队在半导体掩模版领域耕耘多年，具有深厚的技术积累以及良好的技术转化能力；

（2）领先的技术实力。公司在高精度半导体掩模版领域不断进行设备引进与技术攻关，针对半导体掩模版的工艺特点，形成了多项自主研发的核心技术，涵盖CAM、光刻、检测三大环节；

（3）优质且稳定的客户资源。公司与众多知名客户建立了长期稳定的合作，并形成了优质的客户结构，客户不仅涵盖芯片制造厂商、MEMS 传感器厂商、先进封装厂商，还包括进行基础技术研究的知名高校及科研院所；

（4）全面的客户服务能力。公司有着多年的晶圆厂业务磨合经历，积累了大量的服务经验，缩短与新客户的磨合期，提升了与客户的合作粘性。

**7、公司后期还有规划员工股权激励吗？**

回复：半导体行业为技术、人才、资本密集型行业，公司高度重视人才的培养工作，此前公司已经进行了多轮股权激励，未来会持续完善员工激励机制，适时对优秀的人才开展股权激励，实现公司利益、个人利益、股东利益相结合。

**8、公司产品毛利率较高的原因有哪些？**

回复：（1）半导体掩模版行业属于资本密集型和技术密集型行业，高度依赖专有技术，需要长期的研发投入和经验积累；

（2）半导体掩模版对晶圆制造的品质影响重大，但占晶圆制造的成本比例不高，客户更为看重产品品质，对掩模版的价格敏感度较低；

（3）公司凭借不断提升的技术工艺水平逐步通过下游多个大型晶圆制造商客户的评估认证，上述合作关系一旦建立，客户粘性较高；

（4）公司毛利率水平与行业内其他企业的半导体掩模版产品相比差异不大，均处于合理区间内。

**9、掩模版的使用寿命一般是多长？**

回复：掩模版产品在半导体生产中起到光刻模具的作用，可多次曝光和重复使用，具体使用寿命及周期情况与客户的使用方式、使用频率等相关。

	<p><b>10、请问公司研发投入和人才储备的情况如何？</b></p> <p>回复：为保证持续创新能力，公司未来将加大研发资金及研发力量的投入，并推动项目成果转化，不断提升公司在行业的技术实力。同时公司将建立更为完善的知识产权管理体制，加强公司对无形资产和专有技术的保护，并加大专利申请力度，确保公司的核心技术得以保护。在人才储备方面，公司针对拓展 130nm-65nm 节点制程产品具有较为充足的人才储备，公司亦在不断加强技术人才的招募，进一步扩充研发团队，确保募投项目的顺利实施。</p>
<p>本次活动是否涉及应当披露重大信息</p>	<p>否</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 9 月 4 日</p>

(以下无正文，为《深圳市龙图光罩股份有限公司投资者关系活动记录表》之签字页)

采访/调研人员签字：

接受采访/调研人员签字：